

证券代码：600353

证券简称：旭光电子

公告编号：2025-039

成都旭光电子股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币549,999,989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79元，实际募集资金净额为534,504,090.90元。

上述募集资金已于2022年9月5日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	55,000.00
减：发行费用	1,549.59

募集资金净额	53,450.41
减：置换预先投入募集资金金额	12,806.19
减：以前年度使用金额	28,724.80
减：本年直接投入募投项目金额	5,868.06
加：利息收入及理财收益减除手续费	853.37
募集资金余额	6,904.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都旭光电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构华西证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都新都支行、成都银行股份有限公司郫都支行、中信银行股份有限公司成都分行和广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	账户余额
------	------	------	------

成都旭光电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都马超西路支行	4402943029100134835	2,119.54
成都旭光电子股份有限公司	成都银行犀浦支行	1001300001054898	59,438.56
成都旭光电子股份有限公司	中信银行股份有限公司成都锦江支行	8111001012800854425	44,230,755.97
宁夏北瓷新材料科技有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	801101001316867745	24,754,940.86
合计			69,047,254.93

注：中信银行股份有限公司成都银河王朝支行已更名为中信银行股份有限公司成都锦江支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，本次募集资金到位前，公司及实施募投项目的子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司（以下简称“北瓷新材料”）根据募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。自2022年1月21日至2022年9月23日止，公司及北瓷新材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币12,806.19万元。截至2022年9月23日公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币148.34万元。预先投入募投项目及预先支付的发行费用合计12,954.52万元。

公司于2022年9月28日召开的公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计12,954.52万元，上述事项已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于成都旭光电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（川华信验（2022）第0631号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年9月28日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议及2022年10月14日召开的2022年第二次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含）的部分闲置募集资金及不超过1.15亿元（含）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2023年9月22日召开的公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议及2023年10月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，均已在前述授权期限内归还至募集资金账户。本报告期，无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，并经公司2024年第一次临时股东大会审批通过，公司将“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”募集资金投入金额减少6,736.97万元，减少部分调整至“电子封装陶瓷材料扩产项目”，相应增加电子封装陶瓷材料扩产项目的投资总额；“电子封装陶瓷材料扩产项目”及“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司为了“加快电子封装陶瓷材料扩产项目”的投产，该项目实施主体宁夏北瓷曾经存在使用“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”募投项目设备的情况，事后已通过归还上述设备款项的方式予以规范。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				53,450.41			本年度投入募集资金总额			5,868.06		
变更用途的募集资金总额				6,736.97			已累计投入募集资金总额			47,399.05		
变更用途的募集资金总额比例				12.60%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额	截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 (1)	本 年 度 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)=(2)-(1)	截 至 期 末 投 入 进 度 (%) (4) = (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 是 否 发 生 重 大 变 化
电子封装陶瓷材料扩产项目	否	13,670.86	20,407.83	20,407.83	747.12	17,943.91	-2,463.92	87.93	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
电子陶瓷材料产业化项目（一期）	否	31,979.55	25,242.58	25,242.58	5,120.94	21,655.14	-3,587.44	85.79	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,800.00	7,800.00	7,800.00		7,800.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	53,450.41	53,450.41	53,450.41	5,868.06	47,399.05	-6,051.36	-	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				受前期市场环境及技术迭代影响，为进一步提升产品性能，“电子封装陶瓷材料扩产项目”生产设备的安装、优化调试仍需持续推进。同时结合公司目前发展战略要求，拟继续增加“电子封装陶瓷材料扩产项目”建设，因此结合当前募投项目实施进度，为维护公司及全体股东利益，公司经过综合分析和审慎评估，决定对“电子封装陶瓷材料扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。								

	随着国内半导体市场的逐步升级，对相关产品的质量和性能也提出更高的要求，同时，氮化硅基板及HTCC涉及的制造工艺复杂，生产验证周期较长。因此，为确保产品质量与性能稳定，经公司充分考虑和审慎研究，为确保公司募投项目稳步实施，降低募投资金使用风险，保障资金的安全、合理使用，保护公司及投资者利益，结合目前项目实际开展情况，公司决定对“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。 上述事项已经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，并经公司2024年第一次临时股东大会审批通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见报告正文三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见报告正文三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：电子封装陶瓷材料扩产项目实际累计投入含项目募集资金利息收入 9.86 万元。

注 2：经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审批通过，决定将“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”募集资金投入金额减少 6,736.97 万元，减少部分调整至“电子封装陶瓷材料扩产项目”，电子封装陶瓷材料扩产项目调整后承诺投入金额为 20,407.83 万元。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度（%） （3）=（2）÷（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电子封装陶瓷材料扩产项目	电子封装陶瓷材料扩产项目	20,407.83	747.12	17,943.91	87.93	2025 年 12 月	不适用	不适用	不适用
电子陶瓷材料产业化项目（一期）	电子陶瓷材料产业化项目（一期）	25,242.58	5,120.94	21,655.14	85.79	2025 年 12 月	不适用	不适用	不适用
合计	-	45,650.41	5,868.06	39,599.05	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			1、“电子封装陶瓷材料扩产项目”：随着第三代半导体技术的快速发展，市场对散热效率提升和功耗降低的需求愈加凸显。氮化铝材料因其出色的导热和散热性能，市场应用领域不断扩展，其核心作用愈发显著；与此同时，对氮化铝粉体的性能指标也提出了更高要求。随着公司在氮化铝粉体工艺方面取得的突破，现有生产设备及能源配套不足，需进一步增加资金投入。 2、“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”：氮化硅基板涉及的制造工艺复杂，并且生产验证周期较长，因此为保证募集资金使用效益及保护中小投资者权益，为进一步加强募集资金使用的统筹规划，经公司结合实际需要谨慎研究决定，在保持募投项目实施主体、投资总额不变的情况下，将“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”中氮化硅生产线计划不再使用募集资金投入，未来拟使用自有资金投入。 综上，“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”减少的募集资金投入调整至“电子封装陶瓷材料扩产项目”。上述事项已经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审批通过。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			详见附表 1 之“未达到计划进度原因”						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						